



[kingston.com/emcp](http://kingston.com/emcp)

## eMCP

### **A solução perfeita de armazenamento integrado com baixo consumo de energia para dispositivos móveis com restrição de espaço, IoT e aplicativos integrados**

A Kingston oferece uma série de componentes eMCP padrão JEDEC. O eMCP integra armazenamento em Cartão Multimídia Integrado (eMMC) e DRAM Low-Power Double Data Rate (LPDDR) em um Pacote Multi-Chip (MCP) com um pequeno formato. Esta solução oferece maior integração, reduzindo o tamanho geral. O eMCP é a combinação ideal de armazenamento e componente de memória para sistemas com espaço restrito como smartphones, tablets, wearables (vestíveis) e vários dispositivos IoT (Internet das coisas).

## BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

- Soluções flash NAND gerenciadas que simplificam o design e o manutém do produto com uma interface eMMC padrão do setor. Isso reduz significativamente a complexidade do design e o ciclo de qualificação.
- A combinação de memória e armazenamento altamente integrada reduz o espaço no design do sistema, tornando o eMCP uma solução ideal para aplicativos de formato pequeno.
- DRAM com baixo consumo de energia reduz o consumo geral de energia, tornando o eMCP uma solução perfeita para muitos aplicativos alimentados por bateria, como wearables e produtos IoT móveis.
- Redução da complexidade da Lista de Materiais com diminuição no número de componentes.
- Várias configurações de firmware disponíveis para melhor se ajustar às suas necessidades de aplicativos em termos de desempenho, energia e vida útil.

## SEGMENTOS DE MERCADO



Smartphonos e Tablets



Vestíveis



Aceleradores IA



IoT

## CÓDIGOS DO PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES eMCP

### eMCP baseada em LPDDR3

Código do produto	Capacidade		Padrão		Embalagem (mm)	FBGA	Temperatura de operação
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM			
04EM04-N3GM627	4	4	5.0	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C a +85°C
08EM08-N3GML36	8	8	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C a +85°C
16EM08-N3GTB29	16	8	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C a +85°C
16EM16-N3GTB29	16	16	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C a +85°C
32EM16-N3GTX29	32	16	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C a +85°C
32EM32-N3HTX29	32	32	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,1	221	-25°C a +85°C
64EM32-N3HTX29	64	32	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,1	221	-25°C a +85°C

### eMCP baseada em LPDDR4x

Código do produto	Capacidade		Padrão		Embalagem (mm)	FBGA	Temperatura de operação
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM			
04EM08-M4EM627	4	8	5.1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	149	-25°C a +85°C
16EM16-M4CTB29	16	16	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C a +85°C
32EM16-M4CTX29	32	16	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C a +85°C
32EM32-M4DTX29	32	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C a +85°C
64EM32-M4DTX29	64	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C a +85°C
128EM32-M4DTX29	128	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,1	254	-25°C a +85°C



ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.

©2022 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA.

Todos os direitos reservados. Todas as marcas ou marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. MKF-961BR